用恒星 点亮未来

----恒玄科技2022校园招聘

恒玄科技（688608.SH）成立于2015年，于2020年登陆科创板上市，是全球领先的AIoT芯片供应商，专注研发业界领先的低功耗智能无线音频/语音技术，打造智能物联网场景下，具有人机交互能力的低功耗边缘智能无线SoC芯片，持续推出多款具有高集成度和高性能的智能无线音频芯片产品，包括智能TWS蓝牙耳机音频芯片、WiFi智能音箱芯片、智能手表芯片等。

恒玄科技拥有国际领先的智能无线音频芯片研发中心，团队具备优秀的射频/模拟/音频、电源管理、无线通信、远近场声学降噪算法、嵌入式AI、低功耗SoC和软件架构的综合研发能力，拥有超过200项领先自主知识产权。产品成功打入华为、三星、小米、OPPO、VIVO、谷歌、阿里、百度、索尼、哈曼、JBL、万魔、漫步者等国内外知名品牌，在无线智能音频领域处于全球领先地位。

恒玄科技在北京、上海、深圳、成都、武汉、首尔等地设有办公室，我们热烈欢迎菁英人才的加入，为中国集成电路事业崛起而奋斗！

**招聘流程**

简历投递-简历筛选-笔试—面试-录用沟通-签约

**简历投递**

请进入网申地址：https://app.mokahr.com/m/campus\_apply/bestechnic/41174

投递简历！

**扫描二维码，关注“恒玄科技”了解更多**

****

招聘岗位

**软件类岗位**

**嵌入式软件开发工程师（上海，北京，深圳，成都，武汉）**

职责描述：

1）负责嵌入式BSP软件开发，内核开发；和/或

2）负责嵌入式应用软件开发；和/或

3）无线连接协议的软件开发（比如蓝牙，WIFI）

任职要求：

1）本科或以上学历，电子或计算机相关专业；

2）熟练掌握C/C++语言编程；

3）有较强独立解决问题的能力，具备良好的编程习惯，对技术有浓厚兴趣；

4）如果满足下述条件之一，优先录取：

    a）有嵌入式相关领域或者Linux开发经验；

    b）了解蓝牙协议、WIFI协议，或者有相关项目开发经验；

    c）获得班级、年级学习荣誉，参加过电子设计等竞赛获奖

**芯片类岗位**

**射频模拟电路设计（上海）**

职责描述：

1. 设计各种芯片的射频，模拟，音频，高速接口，电源管理相关电路，包括但不限于

射频电路（LNA，Mixer，PA，PLL，PassiveDevice等）

模拟电路（ADC，DAC，Opamp，Driver等）

电源管理电路（DCDC，Charge Pump，LDO，Bandgap等）

高速接口（DDR，Serdes，PCIE，USB，PLL，CTLE等）

2. 独立完成或协助版图工程师完成高质量的版图设计

3. 协助应用工程师完成相关模块的测试任务

任职要求：

1. 硕士及以上学历，微电子相关专业；

2. 本科硕士成绩优秀，电路基础扎实，在国际顶级会议或期刊发表论文者优先；

3. 有相关射频模拟模块流片经验，国内国际科创比赛获奖或先进工艺设计经验者优先；

4. 自我驱动，工作认真负责，具有良好的沟通和团队协作能力

**数字电路设计工程师 ( 北京、上海、成都)**

职责描述：
1. 设计验证数字接口模块；
2. 设计验证数字信号处理模块；

3. 设计验证图形/图像/视频模块和硬件加速模块；
4. IP集成，SOC设计；
5. 设计验证时钟系统，控制系统和安全系统；
任职要求：

1. 本科及以上学历，微电子相关专业；
2. 熟练使用Verilog/VHDL做逻辑设计，有模块级原生设计能力；
3. 熟悉数字信号处理或者高速数字接口，熟悉图形/图像/视频或者机器学习；
4. 熟悉多时钟域和多电源域设计；
5. 能描述模块SDC约束，熟悉数字前端流程，清晰理解概念；
6. 有学习能力，能自我驱动，能良好沟通合作。

**数字电路验证工程师（北京、上海、成都）**

职责描述：
1. 维护/开发验证平台；

2. 构建测试用例，完成模块级和芯片级设计的验证；

3. 为设计团队提供验证支持；

4. 提高验证质量和效率；

任职要求：
1. 本科及以上学历，微电子等相关专业；

2. 有完整和成功的芯片验证经验的优先；

3. 精通Verilog，SystemVerilog和UVM；

4. 精通C语言和脚本语言（Perl / Shell / Makefile / Python /...）；

5. 熟练EDA验证工具，掌握验证方法；

6. 有学习能力，能自我驱动，能良好沟通合作。

**数字实现工程师（上海、北京）**

职责描述：1. 数字实现, 从 RTL 到 GDS；

2. 数字综合，DFT；

3. 后端布局规划；

4. 功耗分析；

5. 静态时序分析；

6. 定制标准单元库。

任职要求：1.了解模拟和数字电路知识，了解半导体物理，器件和工艺；

2.了解版图设计；

3.具备熟练的脚本技能（Shell, TCL，Perl，Python）；

4.熟练Cadence 或 Synopsys 前后端工具；

5.有良好的时序收敛经验；

6.熟悉关于 OCV，LVF，MMMC, CPF, UPF 等知识。

**硬件类岗位**

**硬件工程师（北京、深圳、成都）**

职责描述：
1.硬件板级的开发及调试；
2.硬件BT/WIFI常规的射频及音频测试；
3. 客户硬件支持；
4. 硬件相关文档撰写及整理。
任职要求：
1.本科及以上学历，电子信息、微波通信及电路与系统等相关专业；

2、具有扎实的电路分析、射频电路设计、电磁场和微波方面的理论基础；

3.熟悉常用用仪器使用用，AP，频谱仪，信号源，BT/WIFI相关的测试仪等；

4.掌握包括阻抗匹配，传输线理论、双端口网络，smith圆图等基础理论；

5.熟悉ADS、HFSS或COMSOL等电磁仿真设计软件；
6.有手机和BT/WIFI工作经验的优先；

7.获得班级、年级学习荣誉，参加过电子设计等竞赛获奖者优先。

**硬件应用工程师（上海）**

职责描述：
1. 参与无线音频芯片产品的硬件功能定义；
2. 负责完成芯片EVB设计，器件选型，PCB绘制，跟进板卡加工及焊接；
3. 芯片测试平台的搭建，完成芯片研发验证，芯片调试和测试；
4. 形成测试报告,编写相应用户指南以及最终硬件电路参考设计等；
5. 给客户进行培训，帮助客户解决研发和产生生产过程中遇到的技术问题。
任职要求：
1. 本科及以上学历，电子信息、微波通信及电路与系统等相关专业；
2. 具备一定射频理论基础以及无线通讯相关基本知识；
3. 熟练使用常见电路设计EDA软件如PADS、Protel或Cadence中的一种；
4. 熟悉常见射频通讯仪表，熟悉音频和电源相关测试，具有一定动手能力及实际项目经验者优先；
5. 善于沟通，具备较好的团队协作能力，能够适应灵活出差；
6. 具有一定英文技术文档阅读能力；

7. 较强的学习能力，自我驱动性强。

**算法类岗位**

**通信系统工程师（北京）**

职责描述：

1.对通信系统的物理层协议进行算法研究与数学仿真；

2.对通信系统中的干扰、杂波和信道等进行算法研究与数学仿真；

3.对通信系统的芯片实现提供模型和理论依据；

任职要求：

1.电子信息、通信、计算机通信、应用数学或相关专业硕士及以上学历；

2.熟练掌握通信和信号处理专业的基础知识；

3.熟悉matlab/c/c++等仿真工具。

**音频算法工程师（上海）**

职责描述：
1. 负责音频编解码的优化，移植以及音效开发；
2. 负责语音前端信号处理算法回声消除，语音增强，声纹识别等的开发；

3. 负责远场和近场的语音识别方案优化；

4. 相关驱动和调试文档的撰写；
5. 跟踪和研究音频标准及降噪算法的最新进展。
任职要求：
1.电子信息、机器学习、计算机通信，应用数学或相关专业硕士及以上学历，语音信号处理专业优先；
2.熟悉C,Matlab,Python；
3.有音频信号处理算法经验优先；

4.熟悉语音识别算法者优先；
5.良好的专业通信英文文献阅读和资料搜索能力；
6.具有较强的工作和学习热情,能不断自我充电,更新知识。

**音频/声学工程师（深圳）**

职责描述：
1.负责通话算法，音效算法及远场算法的调试和测试；
2.负责通话及Audio工具的研发和实现；
3.负责与客户沟通，了解客户需求并解决客户提出的问题。
任职要求：
1.本科及以上学历，计算机、信号处理等相关专业；
2.有信号处理专业背景，语音信号处理专业优先；
3.熟悉C，Matlab；
4.有语音信号处理算法调试经验；

5.英语听说读写熟练；
6.学习能力强，有良好的团队协作精神，善于发现并解决问题；

7.获得班级、年级学习荣誉，参加过电子设计等竞赛获奖者优先。

**机器学习工程师（上海）**

职责描述：

1.负责机器学习，深度学习的理论研究和算法、模型开发；

 （1）包括但不限于超参优化、神经网络架构搜索

 （2）包括但不限于基础的算法或模型，如CNN、RNN、DNN、LSTM、GRU

2.对以上模型做算子优化，如模型压缩、算子加速、模型量化等；

3.了解信号处理，语音识别，语音降噪，声纹识别，多传感器融合等相关领域知识；

4.基于采集的样本搭建智能标注、特征提取、自动学习、训练和推理系统平台。

任职要求：

1.硕士及以上学历；

2.有计算机，数学，信号处理或机器学习专业背景；

3.熟悉C，Matlab，Python；

4.有深度学习研发经验优先；

5.英语六级及以上；

6.学习能力强，有良好的团队协作精神。

**运营类岗位**

**产品工程师（封装设计）（上海）**

职责描述:

1. 设计 BGA, QFN,WLCSP 等封装：包括封装尺寸评估，基板设计，打线设计等；

2. 与芯片研发协作，完成射频模拟，电源数字，高速接口等相应的 layout 要求；

3. 与封装厂协作，优化封装设计：降低封装生产风险，降低封装成本；

4. 完成封装电性能建模和仿真；

5. 新产品导入封装厂试产，和封装相关的优化迭代；

6. 通过相关测试和仿真，制定封装Guideline。

任职要求:

1. 微电子、材料、物理及相关EE专业本科及以上学历；

2. 熟悉 Cadence Allegro Package Designer，Auto CAD， HFSS等；

3. 积极主动，有责任心。

**芯片测试开发工程师（上海）**

全流程负责芯片自动测试开发，包括测试硬件设计、测试程序开发、测试执行、成本降低和质量提升，保证测试的可信和高效。

具体职责如下：
1. 制定芯片的自动测试方案；
2. 设计制作Load Board、Probe Card、Socket等测试相关硬件；
3. 基于自动测试平台，开发测试程序并调试；

4. 对测试程序和测试数据不断分析优化，确保测试覆盖率、稳定性、一致性以及成本达到预期目标；
5. 对研发和客户反馈的芯片问题进行分析验证，提升芯片的质量；

6. 洞察业界先进测试技术的动向和创新，满足公司创新领域的测试需求，并不断改进测试方法，提升测试效率和质量。

任职要求：

1. 微电子、材料、物理及相关EE专业本科及以上学历；

2. 了解编程/电路/信号分析基础知识；
3. 积极主动，有责任心。

**芯片质量&可靠性工程师（上海）**

职责描述：

1. 负责芯片产品生命周期的可靠性评估：

    \* 芯片高温操作寿命（HTOL）的硬件制备；

    \* 完成可靠性测试向量的准备和调试；

    \* 静电测试与闩锁测试；

    \* 高温，高湿带电环测实验（HAST/THB）等；

2. 负责芯片封装可靠性测试；

3. 负责失效样品的失效分析；

4. 负责产品可靠性认证报告的撰写；提出原因分析和改善建议；

5. 针对其他特殊可靠性测试要求，提供方案；

6. 公司产品可靠性规范文件的完善。

任职要求：

1，半导体，微电子相关专业硕士及以上学历；

2，英语良好。具有一定的编程基础；了解芯片工作及测试的基本原理；

3，具备一定的电路分析能力及硬件调试能力；

4，具备良好的沟通能力与项目管理能力，对待工作态度积极，认真负责，抗压能力强。

**财务管培生（上海）**

职责描述：

1.丰富的轮岗机会，包括：各会计岗位（包括不限于应收、应付、销售收入、费用等）、财务分析岗位、司库岗位、内审岗位等；

2.参与制度和流程的制定与完善，从中学习并实践先进的管理思路；

任职要求：

1.教育背景: 财务、经济、审计、金融等相关专业本科及以上学历；

2.工作主动认真，责任感强，能吃苦耐劳，踏实肯干，自我驱动，愿意奋斗；

3.具有良好的沟通和协调能力，较强的风险控制和数据分析能力，逻辑清晰；

4.具备较强的执行力和团队合作能力；

5.具有风险意识、严谨细致，责任心强；

6.具有良好的敬业精神和职业道德操守。